

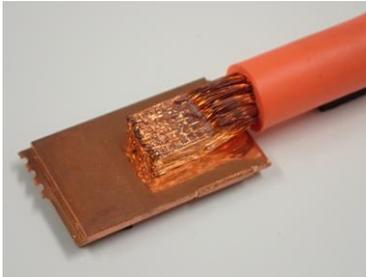
## パワー系デバイスに最適な超音波接合機



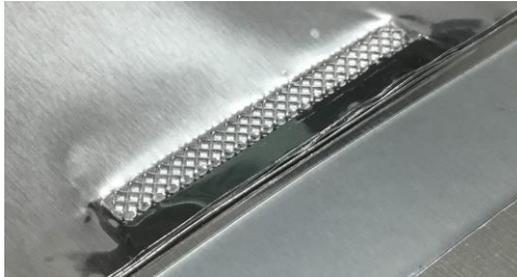
ヘッド荷重	UB2000 : 荷重 50~2000N、UB3000 : 荷重 50~3000N、UB5000 : 250~4400N
ヘッド種類	超音波ヘッド
超音波周波数	周波数 : 15kHz(3000W、4000W)、19kHz(3000W、4000W)、30kHz(1250W)
ヘッド制御	荷重、超音波のデジタル制御
接合モニタリング	プロファイル参照ソフト標準搭載
レシピ	接合条件 : デジタル設定
ユーティリティ	空圧源 : 0.5MPa ドライクリーンエアー 電源 : 本体 200V10A 発振器 15kHz 200V20A、19kHz 200V20A、30kHz 200V10A
ユニットサイズ	W900 × D900 × H1650mm (本体部)
ユニット重量	800kg

### アプリケーション

#### ●太線接合



#### ●金属箔一括接合

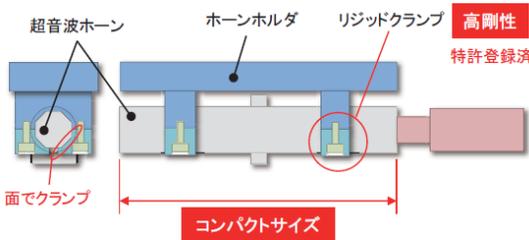


#### ●ヒートシンク (ピン接合)



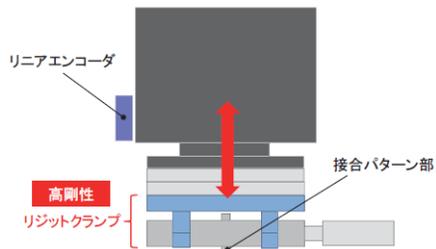
### 高剛性ホーンクランプ機構

【リジットクランプ】によって、超音波ホーンをダイレクトにクランプ。これにより超音波ヘッドは高剛性、かつコンパクト。



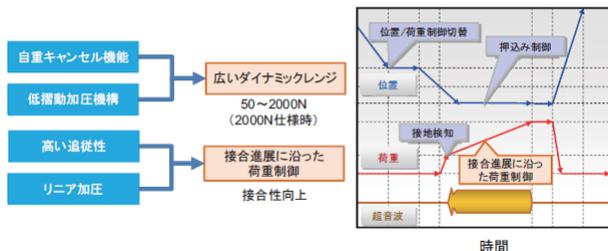
### 高精度位置制御

接合ヘッド内蔵のリニアエンコーダとリジットクランプにより高剛性の超音波ホーンユニットで接合部の位置を正確に制御



### 高機能荷重制御

低撓動加圧機構による広いダイナミックレンジを実現。接合時の変形に高い追従性を持ち、接合進展と共に荷重をあげるリニア加圧により接合性が向上



### 充実したプロセスモニタリング機能

装置に内蔵された各種センサ情報により、プロセス動作を詳細に把握でき、プロセス立ち上げ、量産管理に有効。

